

各 位

2021年7月30日

会社名 AIメカテック株式会社
代表者名 代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄
(コード番号 6227 東証第二部)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 岡部 隆志
(TEL 0297-62-9111)

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ

当社は、本日、2021年7月30日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、当社グループの2021年6月期(2020年7月1日～2021年6月30日)の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきまして別添のとおりであります。

記

【連結】

(単位：百万円、%)

	2021年6月期 (予想)			2021年6月期 第3四半期累計期間 (実績)		2020年6月期 (実績)	
	対売上 高比率	対前期 増減率		対売上高 比率		対売上高 比率	
売 上 高	16,160	100.0	11.3	11,239	100.0	14,521	100.0
営 業 利 益	961	5.9	105.3	193	1.7	468	3.2
経 常 利 益	907	5.6	129.0	135	1.2	396	2.7
親会社株主に帰属する当期純利益	615	3.8	111.3	93	0.8	291	2.0
1株当たり当期純利益	109円24銭			16円66銭		51円76銭	
1株当たり配当金	未定			—		—	

(注) 2021年3月20日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。上記では、2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期(四半期)純利益を算出しております。

【2021年6月期業績予想の前提条件】

1. 当社グループ全体の見通し

当社は2016年7月1日に株式会社日立製作所からの新設分割により設立されました。『先進・革新技術で未来を創造』を経営理念に掲げ、常にチャレンジ精神をもってお客様のニーズにお応えすることを目標としております。

当社グループは、当社と連結子会社1社で構成されており、産業用のインクジェット・プリンタ（IJP）製造装置等の「IJPソリューション事業」、半導体パッケージの実装に用いられる、はんだボールマウンタ装置等の「半導体関連事業」、液晶ディスプレイ（LCD）製造装置等の「LCD事業」の3事業において、各種装置の開発・製造・販売及びアフターサービスを行っております。

セグメント毎の活動計画は次のとおりです。

IJPソリューション事業におきましては、これまで積み上げてまいりました微細塗布や位置合わせのコア技術をベースとしたインクジェット装置の開発により、高付加価値化・高機能化が進む有機ELを始めとする次世代プレミアム・ディスプレイに向けて、性能及び信頼性の高い装置を提供してまいります。また、IJP技術を利用したローコスト・プロセスの実現やエレクトロニクス分野及び医療分野など未来を創造するテクノロジーに向けて新たなソリューションを提供してまいります。

半導体関連事業におきましては、次世代通信規格（5G）やIoT、AIに伴う情報通信関連の需要が増加する中、高品質で安定した量産プロセスとユニットの大型化に対応した新型のはんだボールマウンタ装置をリリースいたしました。高性能化が進む半導体パッケージへの展開に加えて、ウェア向けにも対象を拡げ、更なる対応範囲の拡大を進めてまいります。

LCD事業におきましては、G10.5世代の大型LCD設備投資がピークアウトした中、今後はこれまで納入してきた設備の状況をきめ細かく把握し、プロセスサポート（既に納入した設備の最適運用サポート、新製品の立上げを目的とした材料選定、プロセスの検証）、リニューアル提案（最新の製品を製造するための改造や生産能力向上を目的とした提案活動）等のLCS（ライフサイクルサポート）活動を通じて、顧客に最高のコンディションで製品を生産いただくためのサポートを提供し、安定的な収益を確保してまいります。

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により経済活動が停滞する一方で、当社が対象とする半導体やFPD（フラットパネル・ディスプレイ）業界においては巣ごもり需要が拡大し、足元設備投資が回復しています。当社の顧客は海外が主体であります。海外渡航に未だ制約がある中、装置立上げ作業の現地化を推進し、また販売面におきましては当社の子会社・支店、更に販売代理店との連携を強化し対応を図っております。

当社グループにおける2021年6月期の連結業績については、第3四半期までの実績と第4四半期の見通しを踏まえ、売上高16,160百万円（対前期比11.3%増）、営業利益961百万円（同105.3%増）、経常利益907百万円（同129.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益615百万円（同111.3%増）を予想しております。

2. 売上高

当社は受注生産で販売を行っております。このため売上計画は、原則個々の案件の積み上げにより策定しております。具体的には、既受注の案件については契約等に基づいて金額・時期を計画に織り込み、未受注の案件については、基本的に顧客からの案件の引き合い、顧客との商談・ヒアリングによる情報、研究開発等の進捗状況等から、売上金額や計上時期を見積もることができる案件について積み上げを行っております。また当社の特徴として、受注から生産、出荷までに相応の期間を要することから数カ月先までの売上高を一定程度見通せる反面、数億円単位の案件が多いことから顧客の投資計画見直し・延期等により売上計上時期が変動するリスクがあります。

さて、以下、セグメント毎の売上高（予想）について説明いたします。

I J Pソリューション事業は、第3四半期までの売上高は2,011百万円（対前年同期比313.8%増）と、プレミアム・ディスプレイ向けなど大口の試作機の納入が多くあったことから大幅な増収となりました。第4四半期においては小口の案件が主体となっており、通期では売上高2,299百万円（対前期比312.0%増）の仕上がりを見込んでおります。

半導体関連事業は、第3四半期までの売上高は1,586百万円（対前年同期比141.6%増）と、次世代通信規格（5G）対応等により活況を呈する半導体市場の恩恵を享受し、好調に推移しております。第4四半期においても売上の拡大が続いており、同四半期だけで20億円強の売上が見込まれ、通期の売上高は3,720百万円（対前期比124.5%増）と予想しております。

LCD事業は、コロナ禍の巣ごもり需要による液晶パネルの需給改善を受け、第3四半期までの売上高は7,642百万円（対前年同期比11.8%減）となりました。液晶パネルの需給改善の影響はプラス面とマイナス面があります。プラスの影響は新規のLCD設備投資の活発化による売上の増加、マイナスの影響はLCS案件で計画していた売上の減少です。需給がひっ迫する中、顧客が生産を優先し、設備の改造・リプレースを先送りにしたことからLCS案件の売上は前年同期を下回り、LCD全体では減収となりました。第4四半期においてもこの傾向は続いており、通期では売上高10,141百万円（対前期比17.6%減）が見込まれます。

これらの結果、全体では通期で売上高16,160百万円（前期比11.3%増）を見込んでおります。

3. 営業利益

上述のとおり、当社では個々の案件の積み上げにより計画を策定しており、売上原価についても原則案件毎に過去の実績や現在の原材料価格等を基に費用を見積もっております。一方で計画策定時においては、原価低減、効率化等の検討も行っております。具体的には、ロスコストの極小化、複数購買徹底による調達コスト削減等による原価率の抑制、製品構成割合の変化に応じた人員配置の見直し、複数製品の製作対応が出来る「多能工化」の推進等固定費抑制の効果も加味しております。

第3四半期までの売上原価は9,399百万円（対前年同期比17.9%増）となりました。売上原価率が対前年同期比で2.3%上昇していますが、これは当期前半にコロナ対応で追加費用が発生したほか、一部試作・開発案件で費用の嵩んだ案件があったためです。しかし、第4四半期は原価率の低い半導体関連事業の売上比率が高く、また上述の特殊事情もないことから原価率は低下、通期で前期を下回り、売上原価は12,866百万円（対前期比9.1%増）を見込んでおります。

販売費及び一般管理費においては荷造運搬費の割合が高く、当該費用の3割程度を占めております。荷造運搬費については、個別の製品出荷ごとに合理的な梱包に努め、運送会社と協議するなど、コストの圧縮に努めております。営業部門、間接部門におきましては、人員の配置や諸経費内容の見極めを行い、不必要な費用の上昇を抑えて行く考えで進めております。こうした努力の結果、第3四半期までの販売費及び一般管理費は1,646百万円（対前年同期比3.7%減）と63百万円の減少となりましたが、通期では販売促進費の増加により2,333百万円（対前期比3.2%増）と若干の増加に転じる見込みです。販売促進費は主に販売代理店への手数料や設備納入後の顧客サイトにおける協力会社等による生産立会の費用が計上されています。第4四半期に半導体関連事業の手数料の支払いが増加することに加え、新型コロナウイルス感染症対策による顧客サイトでの現地化推進による費用の増加を見込んでいます。

以上の売上高と費用を受け、2021年6月期の営業利益は961百万円（対前期比105.3%増）を予想しております。

セグメント別では、I J Pソリューション事業が21百万円と新技術・新装置に係る開発案件が主体であったため利益率は0.9%と低いものの黒字転換が見込まれます。今後当該装置が量産化に入る見込みであり、2022年6月期以降は更なる改善が期待しております。

半導体関連事業の当期の営業利益は1,079百万円(同205.7%増)と、増収に加え新機種の導入等による標準化の進捗もあり、大幅な増益を見込んでおります。同じくLCD事業は、745百万円(同31.5%減)と減収に加え、採算の良いLCS関連の比率が下がったことから利益率も若干低下し、大幅な減益が見込まれます。このほか調整額として共通費用を▲884百万円見込んでおります。

4. 営業外損益、経常利益

営業外損益については、受取利息、支払利息、コミットメントフィー、エージェントフィー等を過去の実績を基に計画しております。なお、為替差損益については、当社は輸出が9割を占めているものの、ほぼすべてが円建ての契約であることから計画では見込んでおりません。

第3四半期までの営業外損益は▲59百万円と前年同期の▲56百万円(注:受取保険金23百万円の特別損益への振替後)とほぼ変わっておりません。通期では▲54百万円とやや改善を見込んでおります。前期と比較すると▲71百万円から17百万円の改善となりますが、これは金利負担の軽減によるものです。当社では運転資金の借入を行っていますが、前期は後半よりコロナ禍の影響で借入金が大幅に増加しました。今期は次第に落ち着きを取り戻し、借入金は減少しております。

以上の結果、2021年6月期の経常利益は907百万円(対前期比129.0%増)を予想しております。

5. 特別損益、親会社に帰属する当期純利益

特別損益等は第3四半期までは発生しておらず、通期でも見込んでおりません。因みに、前期においては、災害被害に係る受取保険金と損失が両建てで計上され、差し引き23百万円の利益となっておりましたが、2021年6月期においては斯かる特殊要因はありません。

以上の結果、2021年6月期の親会社に帰属する当期純利益は、税金等を控除し、615百万円(対前期比111.3%増)を予想しております。

【業績予想に関するご留意事項】

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合がございます。

以 上

2021年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2021年7月30日

上場会社名	A Iメカテック株式会社	上場取引所	東
コード番号	6227	URL	http://www.ai-mech.com/
代表者	(役職名)代表取締役社長	(氏名)阿部 猪佐雄	
問合せ先責任者	(役職名)執行役員経営企画部長	(氏名)岡部 隆志	(TEL)0297-62-9111
四半期報告書提出予定日	—	配当支払開始予定日	—
四半期決算補足説明資料作成の有無	: 無		
四半期決算説明会開催の有無	: 無		

(百万円未満切捨て)

1. 2021年6月期第3四半期の連結業績(2020年7月1日~2021年3月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年6月期第3四半期	11,239	14.6	193	54.2	135	45.6	93	80.8
2020年6月期第3四半期	9,804	△0.2	125	△48.7	92	△55.6	51	△18.2

(注) 包括利益 2021年6月期第3四半期 131百万円(238.8%) 2020年6月期第3四半期 38百万円(△31.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年6月期第3四半期	16.66	—
2020年6月期第3四半期	9.21	—

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

2. 当社は、2021年2月24日開催の取締役会の決議に基づき、2021年3月20日付で普通株式1株につき、50株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年6月期第3四半期	17,163	6,858	39.9	1,217.88
2020年6月期	20,049	6,727	33.5	1,194.59

(参考) 自己資本 2021年6月期第3四半期 6,856百万円 2020年6月期 6,725百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年6月期	—	0.00	—	0.00	0.00
2021年6月期	—	0.00	—	—	—
2021年6月期(予想)	—	—	—	—	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年6月期の連結業績予想(2020年7月1日~2021年6月30日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	16,160	11.3	961	105.3	907	129.0	615	111.3	109.24

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数（四半期累計）

2021年6月期3Q	5,630,000株	2020年6月期	5,630,000株
2021年6月期3Q	—	2020年6月期	—
2021年6月期3Q	5,630,000株	2020年6月期3Q	5,630,000株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
（1）経営成績に関する説明	2
（2）財政状態に関する説明	3
（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
（1）四半期連結貸借対照表	4
（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
（継続企業の前提に関する注記）	7
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）	7
（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）	7
（セグメント情報等）	8
（重要な後発事象）	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

（1）経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、コロナ禍の中、足下においてワクチンの普及による景気回復の兆しが見られるものの、変異株の流行や先進国と新興・途上国とのワクチン普及の格差等から未だ不透明な状況が続いております。日本国内におきましても、4月に3度目の緊急事態宣言が発令されるなど新型コロナウイルスの感染収束が見えず、景気の下振れが懸念される状況にあります。

一方、当社グループの事業環境については、フラットパネルディスプレイ（FPD）市場、半導体関連市場ともに回復基調が続いております。FPD市場においては巣ごもり需要によりパネル需給が改善し、半導体関連市場においては次世代通信規格（5G）対応により需要が増加しております。

このような状況のもと、当第3四半期連結累計期間の当社グループの受注金額は、10,924百万円（前年同期比42.7%増）、受注残高は11,615百万円（前年同期比8.1%減）となりました。

当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高11,239百万円（前年同期比14.6%増）、営業利益193百万円（前年同期比54.2%増）、経常利益135百万円（前年同期比45.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益93百万円（前年同期比80.8%増）となりました。

セグメント別の概況は、以下のとおりです。

① I J Pソリューション事業

中国メーカーが10.5世代の大型LCD投資により競争力を強化する中、韓国や台湾のメーカーは次世代ディスプレイの開発やパネルの高付加価値化・高機能化による差別化を図っています。当社は微細塗布などの技術を活かしたインクジェット装置の開発により、QD-OLED、QD-LED等次世代ディスプレイの開発に顧客と協同で取り組んでおります。また、インクジェット技術によるローコストプロセス実現を通じ、従来のFPDや半導体関連以外の分野への取り組みも行っております。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は2,011百万円（前年同期比313.8%増）と大幅な増収となりましたが、セグメント利益は新技術・新製品の開発により初期費用が嵩んだため、7百万円（前年同期比70.0%減）に止まりました。

② 半導体関連事業

5G対応のためのスマートフォン向け高性能プロセッサの需要増、基地局・データセンターの活発な投資、テレワークや巣ごもり需要の増加等から、半導体の需要は拡大基調にあります。米中対立や新型コロナウイルスの感染状況等先行きに不透明感がありますが、半導体は今後も堅調な需要が続くものと思われれます。

こうした中、当社のはんだボールマウンタ装置の売上は好調に推移し、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は1,586百万円（前年同期比141.6%増）、セグメント利益は325百万円（前年同期比129.2%増）となりました。

③ LCD事業

新型コロナウイルスの影響による巣ごもり需要で世界的にパネル需要は高まっており、韓国ではLCD製造装置の停止が延期され、更に中国ではLCD増設の動きすら出て来ています。反面、この需給ひっ迫が顧客の生産優先、設備の維持更新投資先送りへと繋がっており、当社LCSの売上が抑えられる結果となりました。

このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の売上高は7,642百万円（前年同期比11.8%減）、セグメント利益は491百万円（前年同期比17.8%減）となりました。

（2）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ3,147百万円減少し、14,736百万円となりました。主な内容は、売上債権946百万円、棚卸資産1,758百万円それぞれの減少によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から315百万円増加し、2,171百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から27百万円減少し、56百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から27百万円減少し、198百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から2,886百万円減少し、17,163百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ3,010百万円減少し、9,662百万円となりました。主として、仕入債務1,003百万円、前受金1,533百万円それぞれの減少によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ6百万円減少し、642百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ131百万円増加し、6,858百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益93百万円を計上したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は39.9%となりました。

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年6月期の業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間の業績は概ね計画通りに推移したものの、最新の顧客の設備投資動向と業績動向に鑑み、2021年2月8日に公表した数値を以下のとおり修正いたします。

2021年6月期通期の連結業績予想

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	16,585	966	907	617	109円59銭
今回発表予想(B)	16,160	961	907	615	109円24銭
増減額(B-A)	△425	△5	0	△2	—
増減率(%)	△2.6	△0.5	0.0	△0.3	—
(ご参考)前期実績	14,521	468	396	291	51円76銭

※業績見通しについては、現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいております。予想にはさまざまな不確定要素が内在されており、実際の業績は種々の要素により業績予想とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,471,594	2,023,503
受取手形及び売掛金	8,655,967	7,707,648
電子記録債権	3,436	5,122
製品	23,384	3,932
半製品	3,277,001	758,901
仕掛品	3,109,318	3,889,434
原材料	5,494	4,450
未収入金	292,800	332,647
その他	76,553	46,249
貸倒引当金	△31,708	△35,060
流動資産合計	17,883,843	14,736,829
固定資産		
有形固定資産	1,855,792	2,171,352
無形固定資産	84,420	56,718
投資その他の資産	225,931	198,408
固定資産合計	2,166,145	2,426,478
資産合計	20,049,988	17,163,308

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2020年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2021年3月31日)
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	2,921,167	2,150,347
買掛金	2,430,577	2,197,483
短期借入金	4,800,000	4,500,000
リース債務	10,462	9,832
未払金	268,603	153,612
未払費用	124,248	102,825
未払法人税等	88,331	152
前受金	1,719,770	186,397
賞与引当金	171,265	270,185
役員賞与引当金	27,600	24,000
製品保証引当金	46,247	55,415
その他	65,130	12,235
流動負債合計	12,673,403	9,662,486
固定負債		
リース債務	9,233	2,025
役員退職慰労引当金	23,854	30,636
退職給付に係る負債	615,921	609,471
固定負債合計	649,008	642,132
負債合計	13,322,412	10,304,619
純資産の部		
株主資本		
資本金	450,000	450,000
資本剰余金	4,215,238	4,215,238
利益剰余金	2,092,533	2,186,342
株主資本合計	6,757,771	6,851,581
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	△29,630	10,139
退職給付に係る調整累計額	△2,580	△5,045
その他の包括利益累計額合計	△32,210	5,093
新株予約権	2,015	2,015
純資産合計	6,727,575	6,858,689
負債純資産合計	20,049,988	17,163,308

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第 3 四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 2019年 7 月 1 日 至 2020年 3 月 31 日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 2020年 7 月 1 日 至 2021年 3 月 31 日)
売上高	9,804,598	11,239,700
売上原価	7,969,137	9,399,398
売上総利益	1,835,460	1,840,301
販売費及び一般管理費	1,709,744	1,646,499
営業利益	125,716	193,801
営業外収益		
受取利息	2,119	3,174
受取保険金	23,020	—
その他	1,365	383
営業外収益合計	26,505	3,558
営業外費用		
支払利息	35,648	24,151
コミットメントフィー	8,341	12,535
エージェンツフィー	5,000	5,000
為替差損	7,726	15,429
その他	2,747	5,150
営業外費用合計	59,464	62,267
経常利益	92,757	135,092
税金等調整前四半期純利益	92,757	135,092
法人税、住民税及び事業税	148,108	17,854
法人税等調整額	△107,223	23,428
法人税等合計	40,885	41,282
四半期純利益	51,871	93,809
親会社株主に帰属する四半期純利益	51,871	93,809

四半期連結包括利益計算書

第 3 四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 2019年 7 月 1 日 至 2020年 3 月 31 日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 2020年 7 月 1 日 至 2021年 3 月 31 日)
四半期純利益	51,871	93,809
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	△8,812	39,769
退職給付に係る調整額	△4,362	△2,465
その他の包括利益合計	△13,175	37,303
四半期包括利益	38,696	131,113
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	38,696	131,113
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

前第3四半期連結累計期間(自 2019年7月1日 至 2020年3月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結損 益計算書計上 額(注) 2
	I J Pソリ ューション 事業	半導体 関連事業	L C D 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	486,034	656,720	8,661,843	9,804,598	—	9,804,598
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	486,034	656,720	8,661,843	9,804,598	—	9,804,598
セグメント利益	26,315	141,883	598,489	766,688	△640,971	125,716

(注) 1. セグメント利益の調整額△640,971千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれており
ます。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における売上原価・一般管理費△640,971千円であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2020年7月1日 至 2021年3月31日)

1 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計	調整額 (注) 1	四半期連結損 益計算書計上 額(注) 2
	I J Pソリ ューション 事業	半導体 関連事業	L C D 事業			
売上高						
外部顧客への売上高	2,011,127	1,586,397	7,642,174	11,239,700	—	11,239,700
セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	—	—
計	2,011,127	1,586,397	7,642,174	11,239,700	—	11,239,700
セグメント利益	7,935	325,255	491,825	825,016	△631,214	193,801

(注) 1. セグメント利益の調整額△631,214千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれており
ます。全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社における売上原価・一般管理費△631,214千円であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

（特許権侵害差止等請求事件の和解）

当社が東京地方裁判所に訴訟を提起していた、信越エンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区神田錦町二丁目9番地）に対する特許権侵害差止等請求事件（以下、本件）について、2021年4月16日、東京地方裁判所での和解が成立いたしました。

1. 和解に至るまでの経緯

- ①2020年3月16日、本件該当製品の製造・販売等の停止を求める仮処分命令申し立て。
- ②2020年11月16日、仮処分決定。
- ③2021年4月16日、和解成立。

2. 和解内容

和解契約では、本件が和解で解決した事実を除き、原告及び被告双方に守秘義務が課されております。そのため、和解内容につきましては開示を控えさせていただきます。